2018 年 3 月 6 日

各 位

スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長 グループ CEO 阿部 修平
(東証 JASDAQ スタンダード : 8739)

「未来創生ファンド」
指先大 LSI チップで AI と画像処理できる半導体回路設計ベンチャー
ArchiTek 株式会社への投資実行

―サンプル LSI チップの製造と当該チップ上で動くアルゴリズムの開発強化資金に―

当社は、2015 年 11 月に設立した「未来創生ファンド」(以下「本ファンド」という)が、AIと画像処理の半導体回路およびソフトウェアを設計する ArchiTek 株式会社(以下「アーキテック」という)に対する投資(金額は非開示)を実行しましたので、お知らせいたします。アーキテックは、調達資金を指先サイズのプログラマブルなサンプルチップの製造と当該回路上で動くアルゴリズムの開発強化に充当する予定です。

■投資先企業の概要

アーキテックは、2011 年 9 月に、代表取締役の高田周一氏が大手電機メーカーにおいて各種半導体の R&D および製品化に長らく従事した後に独立・起業した会社です。当初の受託開発業務を経て、現在は世界に先駆けて AI と画像処理を僅か 5 ㎜四方の LSI チップで行う半導体(aIPE)の回路設計業務に移行しました。今後益々需要が旺盛となるエッジ部分の IoT の基幹部品として、AI による画像認識や自動運転技術に欠かせない SLAM(※)の実現が期待されています。また、今後の市場開拓をグローバルに推進するためにも、サンプルチップの製造と当該チップで動くアルゴリズムの開発を急ぎます。(http://www.architek.co.jp/)

(※)SLAM(スラム)とは、自己位置推定と環境地図作成を同時に行うこと。 正式名称は、Simultaneous Localization and Mapping(出典:ウィキペディア)

■「未来創生ファンド」の概要

本ファンドはスパークス・グループ株式会社を運営者とし、トヨタ自動車株式会社、株式会社三井住友銀行を加えた3社による総額約135億円の出資により、2015年11月より運用を開始しました。2017年12月末時点では、上記3社を加えた計20社からの出資を受けています。「知能化技術」「ロボティクス」「水素社会実現に資する技術」を中核技術と位置づけ、それらの分野の革新技術を持つ企業、またはプロジェクトを対象に投資を行います。なお、2017年12月末時点での運用額は、367億円で米国、英国、イスラエル、そして日本の約40社に投資しています。(https://mirai.sparx.co.jp/)

■本件に関するお問い合わせ先

スパークス・グループ株式会社 経営管理部
TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101